

請求の範囲

- [請求項1] スラリーを用いた基板の研磨前または後に、研磨テーブル上の研磨パッドに形成された通孔にリンス液を供給して、前記通孔の下方に配置された光学センサヘッドを前記リンス液で洗浄し、
前記リンス液を前記通孔からドレインラインを通じて排出する方法。
。
- [請求項2] 前記通孔を構造体で覆いながら、前記通孔にリンス液を供給する、請求項1に記載の方法。
- [請求項3] 前記研磨テーブルを静止させた状態で、前記通孔を構造体で覆いながら、前記通孔にリンス液を供給する、請求項2に記載の方法。
- [請求項4] 前記研磨テーブルを回転させた状態で、前記通孔を構造体で間欠的に覆いながら、前記通孔にリンス液を供給する、請求項2に記載の方法。
- [請求項5] 前記構造体はウェーハである、請求項3または4に記載の方法。
- [請求項6] 前記研磨テーブル内を延びる液体供給ラインを通じて前記リンス液を前記通孔に供給する、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。
。
- [請求項7] 前記研磨パッドの上方に配置された研磨パッド洗浄ノズルから前記リンス液を前記通孔に供給する、請求項1に記載の方法。
- [請求項8] 前記研磨パッドの上方に配置された研磨パッド洗浄ノズルの下面に向かって前記リンス液を噴射し、前記研磨パッド洗浄ノズルの下面から落下した前記リンス液を前記通孔に供給する、請求項1に記載の方法。
- [請求項9] 前記ドレインラインは、前記リンス液を前記通孔から吸引するためのドレインポンプに接続されている、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の方法。